INFLUÊNCIA DOS PARÂMETROS TÉRMICOS DE SOLIDIFICAÇÃO NA TRANSIÇÃO COLUNAR-EQUIAXIAL DA LIGA AL10%CU, SOB EFEITO DA CONVECÇÃO TERMOSSOLUTAL.

Fabrício SILVA (1); Maurício TAVARES (2); Thiago FERRÃO (3); Diego CORREIA(4); Mayara LIMA (5); Marcelino DIAS (6); Otávio ROCHA (7)

(1) Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, travessa mariz e barros, 2220 - marco, cep:

66093-090, (91) 3228-1719, e-mail: (1)eng.fabriciopaiva@gmail.com

(2) IFPA, e-mail: mauriciodemoraestavares@hotmail.com

(3) IFPA, e-mail: thiagotiger@hotmail.com
(4) IFPA, e-mail: diegodjccs@yahoo.com.br

(5) IFPA, e-mail: <u>maysarisari@yahoo.com.br</u>

(6) IFPA, e-mail: marcelino_dias@hotmail.com (7) IFPA, e-mail: otvrocha@oi.com.br

RESUMO

O processo de fundição representa a mais importante alternativa para a fabricação de produtos metálicos acabados e semi-acabados. As condições térmicas operacionais em que a transformação líquido/sólido ocorre, tais como gradientes de temperatura e taxas de resfriamento, variam de processo para processo e podem também depender tanto do tempo como da posição, por exemplo, em relação à interface metal/molde. Essas condições transientes, combinadas com as diferentes composições das ligas, conduzem a múltiplas possibilidades de obtenção de estruturas finais para um mesmo produto fundido e, por conseguinte, para o seu desempenho mecânico. Durante a mudança de fase líquido/sólido de um material metálico, as variáveis operacionais envolvidas proporcionam o surgimento, ou não, de três zonas estruturais, ou seja, zonas coquilhada, colunar e equiaxial. A caracterização da macroestrutura deste tipo de material consiste no estudo da geometria, dimensão, distribuição e orientação cristalográfica dos grãos obtidos. Considerando o exposto, o presente trabalho consiste na análise dos parâmetros térmicos, influência termossolutal no processo de solidificação da liga Al-10%Cu, com superaquecimento de 10% acima da temperatura *liquidus* da referida liga. A liga foi vazada em um dispositivo refrigerado a água que permite a solidificação unidirecional horizontal . A macroestrutura obtida é analisada assim como é estudada a influência do grau de superaquecimento e quantidade de soluto na formação da transição colunar-equiaxial da liga Al-10%Cu.

Palavras-chave: Solidificação, Transição colunar-equaxial, Superaquecimento, Liga Al-10%Cu.

1. INTRODUÇÃO

A solidificação de materiais pode ser considerada fundamentalmente como um processo de transferência de calor em regime transitório. A transformação liquido/sólido é acompanhada por liberação de energia térmica, com uma fronteira móvel separando as duas fases de propriedades termofísicas distintas. A análise da transferência de calor na solidificação apresenta essencialmente dois objetivos: a determinação da distribuição de temperaturas no sistema material/molde e a determinação da cinética da solidificação. Apesar da crescente industrialização e aplicações dos materiais cerâmicos, polímeros, e compósitos, os materiais metálicos, onde se destacam principalmente o aço, alumínio e suas ligas, continuam sendo bastante aproveitados nas mais diversas aplicações, devido a suas propriedades mecânicas que dificilmente são alcancadas por outros materiais. A melhoria das propriedades dos materiais metálicos se deve ao aumento de seu grau de isotropia. Tal aumento é sensivelmente procedido a partir da macroestrutura homogênea, ou seja, estrutura formada de grãos de pequenas dimensões; sem orientação preferencial de crescimento e distribuídos uniformemente no interior da peça. A macroestrutura de produtos fundidos consiste de três zonas distintas conhecidas, respectivamente, como coquilhada, colunar e equiaxial. A origem de cada uma tem sido objeto de diversos estudos teóricos e experimentais devido a importante correlação existente entre grãos cristalinos e propriedades mecânicas. As referidas zonas podem ou não estar presentes simultaneamente em uma peça fundida, contudo, quando esta apresenta grãos colunares e equiaxiais, ocorre o surgimento da chamada transição colunar-equiaxial (TCE). O estudo da TCE está associado a muitos parâmetros que influenciam durante o processo de solidificação tais como sistema da liga, composição da liga, superaquecimento do líquido, propriedades termofísicas do metal e do molde, coeficiente de transferência de calor na interface metal-molde, taxa de resfriamento, dimensão da peça, convecção no líquido, transporte de soluto, concentração de partículas nucleadoras, direção de crescimento da frente de solidificação, etc (DOHERTY et al., 1977; ARES et al., 2000; SIQUEIRA et al., 2003; WILLERS et al., 2005 e CANTÉ et al., 2007). A previsão da transição em questão é de grande interesse para avaliação e projeto das propriedades mecânicas de produtos solidificados. A dificuldade de estabelecer-se uma correlação entre condições térmicas de solidificação e estrutura resultante tem limitado o desenvolvimento de determinados procedimentos e métodos capazes de elevar a qualidade final de peças fundidas através da ativação de mecanismos que proporcionem a obtenção de grãos equiaxiais (SIQUEIRA et al., 2002).

Considerando o exposto, pode-se afirmar que a importância do conhecimento dos parâmetros térmicos , bem como, seus mecanismos de funcionamento são uma excelente ferramenta para entender, e de certa forma "manipular " esse fenômeno, não só no que se refere a TCE, mas também em outras situações que existem, não abordadas aqui. É importantíssimo também que através desses parâmetros térmicos se chegue a um consenso, no que se refere a fatores influentes na convecção termossolutal para a liga Al-Cu. É importante salientar a quase inexistência de trabalhos que avaliem a influência dos efeitos convectivos na solidificação em condições transitórias de fluxo de calor.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A liga estudada neste trabalho foi devidamente pesada em balança eletrônica nas proporções necessárias para se obter uma liga com 10% de soluto. Inicialmente, foram colocados manualmente os respectivos materiais constituintes da mesma na proporção exata no cadinho de carbeto de silício, revestido internamente por uma camada protetora de tinta à base de caulim, na proporção de 75% de caulim e 25% de água. A temperatura do forno foi programada para garantir superaquecimentos de 10% acima da temperatura *liquidus* da liga

investigada, ou seja, 693,5 °C. Logo após, o cadinho foi retirado do forno e o metal líquido homogeneizado durante um tempo de aproximadamente 25 segundos.

O processo de solidificação consistiu no vazamento da liga Al-10%Cu préviamente fundida em um forno do tipo mufla à resistência detalhado na figura 1 dentro de um molde de chapa de aço 1020, posicionado na parte superior do dispositivo, devidamente aquecido por resistência elétrica à uma temperatura muito próxima da temperatura de fusão. Uma vez atingida a temperatura de vazamento estabelecida,10% acima da temperatura liquidus da respectiva liga, o dispositivo foi desligado iniciando-se o processo de refrigeração através de um fluxo de água constante na parte frontal do dispositivo. A Figura 2 abaixo mostra o dispositivo de solidificação com detalhamento da resistência elétrica. As temperaturas no metal fundido foram monitoradas durante a solidificação através de um conjunto de 5 (cinco) termopares tipo K (1,6 mm diâmetro) localizados no metal líquido nas seguintes posições em relação à interface metal/molde: 5mm, 10mm, 15 mm, 30 mm e 50 mm. Todos os termopares foram conectados por um cabo em um registrador de dados interfaceados com um computador, e os dados de temperatura foram adquiridos automaticamente.



Figura 1- Forno do tipo Mufla adotado para fundir a liga Al-10%Cu.

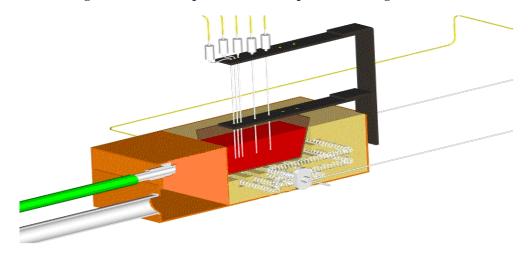


Figura 2 - Dispositivo de solidificação unidirecional horizontal, em corte.

Em seguida, obtido o lingote, foram feitos os procedimentos metalográficos para se obter as revelações macroscópicas através de corte transversal utilizando uma serra de fita com fluido refrigerante; lixamento com as lixas recomendadas, seguidas de ataque químico com composição 5ml de HF; 1,5ml de HNO3,3ml de HCl e 90,5ml de H2O, por imersão em um tempo de aproximadamente (40s).

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

As macroestruturas mostradas nas figuras 3 (a) e (b) apresentam estruturas bem diferentes deixando evidente a importância do superaquecimento na formação de grãos colunares e portanto surgimento da TCE. Na figura3(a) um lingote da liga Al-10%Cu com 5% de superaquecimento cuja estrutura é predominantemente equiaxial, e de grãos mais grosseiros à partir de 75mm da interface metal/molde. Por outro lado, na figura3(b) a mesma liga, Al-10%Cu, porém com 10% de superaquecimento apresenta transição colunar-equiaxial, com o surgimento desta TCE a aproximadamente 45mm da interface metal/molde. Os grãos colunares encontram-se com direção preferencial da extração de calor e com inclinações diagonais, que podem ser explicados pelo efeito da convecção termossolutal.



Figura 3 (b) – macroestrutura da liga Al-10% Cu com 10% de superaquecimento

3.1- Parâmetros Térmicos

A figura (4) apresenta os perfis de temperatura para cada posição de termopar localizados no metal liquido. Para que fossem possíveis os cálculos da velocidade da isoterma líquidus (V_L) foi gerada uma função potência da posição em função do tempo, A derivada desta função com relação ao tempo permitiu a obtenção do respectivo valor experimental para o gráfico V_L = f (p) pode ser observado na figura(5). Em contra partida, os valores das taxas de resfriamento (T_R) foram determinados considerando os dados da análise

térmica experimental obtidos após a passagem da frente líquida por cada termopar. Os resultados obtidos estão indicados nas Figuras abaixo. Finalmente, os gradientes térmicos (G_L) referentes a cada liga estudada foram determinados através de relações analíticas entre as respectivas taxas de resfriamento e as velocidades das isotermas liquidus, ou seja, $T_R = G_L V_L$ (Spinelli et al 2004). Os resultados dos parâmetros témicos referentes a liga Al-10%Cu estudada neste artigo estão apresentados na Tabela 1.

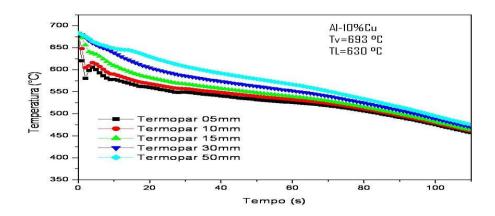


Figura 4- Perfis de temperatura para cada posição de termopar

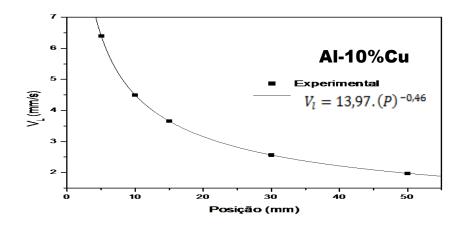


Figura 5- VL em função da posição da isoterma líquidus.

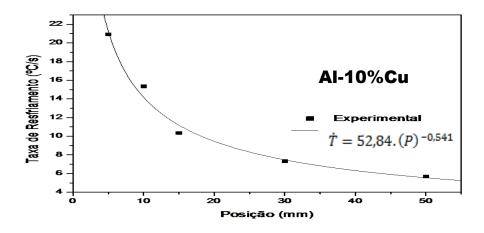


Figura 6- Taxa de Resfriamento em função da posição da isoterma líquidus

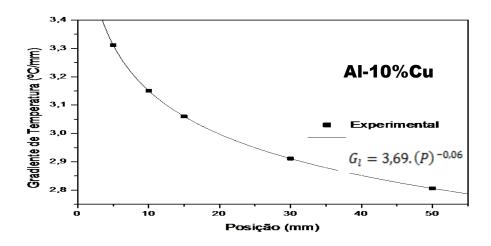


Figura 7- Gradiente de temperatura em função da posição

Tabela 1- parâmetros térmicos para TCE e termopares.

Posição	T _R (°C/s)	VL (mm/s)	G _L (°C/mm)	Posição/ base refrigerada (mm)
TCE	5,5	1,8	2,83	45
Termopar 1	20,08	6,4	3,31	5
Termopar 2	15,2	4,4	3,15	10
Termopar 3	10,1	3,6	3,05	15
Termopar 4	7,2	2,5	2,92	30
Termopar 5	5	1,7	2,8	50

Os dados da tabela 1 foram obtidos pelos cálculos dos parâmetros térmicos experimentais para a liga Al-10%Cu. Observa-se, portanto, pelos gráficos das figuras (6) à (8), a diminuição de V_L , T_R e G_L ao longo do processo de solidificação, isto é, quanto mais afastado da base refrigerada menores serão os valores desse parâmetro. A literatura ainda não está completamente consolidada para determinar o percentual de soluto abordado nesse experimento, mas, assim como a maioria das ligas de Al, é interessante experimentos dessa natureza.

4. CONCLUSÃO

Os resultados alcançados nesse experimento nos permite fundamentar algumas conclusões referentes aos parâmetros térmicos e a Transição colunar – equaxial para o binário Al-10%Cu.

Um deles é que o superaquecimento parece ser mais influente que o teor de soluto no que se refere a ocorrência da TCE, conforme observado nas macrogafias.

Outra observação é que a TCE se faz presente quando a velocidade da isoterma liquidus atinge valor crítico de 1,8mm/s. E também quando o gradiente de temperatura (G_L) a frente da Zona colunar atinge também valores críticos de 2,8 °C/mm.

Outro detalhe importantíssimo é que a convecção termossolutal gera grãos equiaxiais, e a ocorrência da TCE, por meio da quebra de dendritas dos grãos colunares que são então liberadas para a região de líquido localizada à frente da interface de solidificação encontrando condições para crescimento.

REFERÊNCIAS

B. Willers, S. Eckert, U. Michel, I. Haase, G. Zouhar. The columnar-to-equiaxed transition in Pb–Sn alloys affected by electromagnetically driven convection. Materials Science and Engineering A 402 (2005) 55–65.

Gandin, Ch.-A., 2000, "From Constrained to Unconstrained Growth During Directional Solidification", Acta Materialia, Vol. 48, pp. 2483-2501.

Jose N. Silva, Daniel J. Moutinho, Antonio L. Moreira, Ivaldo L. Ferreira, Otavio L. Rocha. The Columnar to equiaxed transition during the horizontal directional solidification of Sn–Pb alloys. Journal of Alloys and Compounds 478 (2009) 358–366.

R.D. Doherty, P.D. Cooper, M.H. Bradbury, F.J. Honey. On the columnar to equiaxed transition in small ingots. Metallurgical Transactions 8A (1977) 397-402.

Siqueira, C.A., Cheung, N. and Garcia, A., 2003, "The Columnar to Equiaxed Transition During Solidification of Sn–Pb Alloys", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 351, pp. 126-134.

Spinelli, J.E., Ferreira, I.L. and Garcia, A., 2004, "Influence of Melt Convection on the Columnar to Equiaxed Transition and Microstructure of Downward Unsteady-State Directionally Solidified Sn–Pb Alloys", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 384, pp. 217-226.

Wang, C.Y. and Beckermann, C., 1994, "Prediction of Columnar to Equiaxed Transition During Diffusion-Controlled Dendritic Alloy Solidification", Metallurgical and Materials Transactions A, Vol. 25A, pp. 1081-1093.

Ziv, I. and Weinberg, F., 1989, "The Columnar-to-Equiaxed Transition in Al 3Pct Cu", Metallurgical Transactions, Vol. 20B, pp. 731-734.

Sturz, L., Drevermann, A., Pickmann, C., and Zimmermann, G., 2005, "Influence of Grain Refinement on the Columnar-to-Equiaxed Transition in Binary Al Alloys", Materials Science and Engineering A, Vol. 413, pp. 379–383.

Hunt, J.D., 1984, "Steady State Columnar and Equiaxed Growth of Dendrites and Eutetic", Materials Science and Engineering, Vol. 65, pp. 75-83.

Canté, M.V., Cruz, K.S., Spinelli, J.E., Cheung, N. and Garcia, A., 2007, "Experimental Analysis of the Columnar-to-Equiaxed Transition in Directionally Solidified Al–Ni and Al–Sn Alloys", Materials Letters, Vol. 61, pp. 2135-2138.